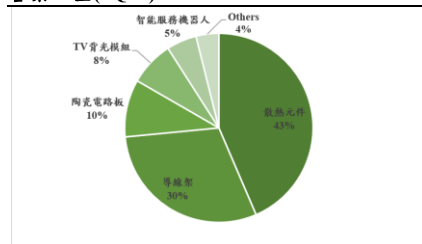


2026/07/23

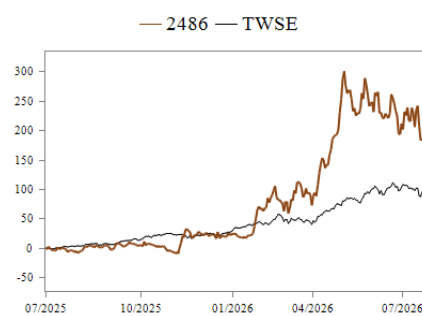
公司基本資訊

目前股本(百萬元)	2,387
市值(億元)	555
目前每股淨值(元)	22.54
外資持股比(%)	10.86
董監持股比(%)	16.01

營業比重(1Q26)



個股與大盤走勢(%)



鄭子凡
Jasmin.cheng@ctbcsis.com

©研究分析標的公司為本公司關係企業之客戶。

電子上游-LED 及光元件

一詮 (2486TT)

一詮成名，AI 散熱開花結果

- 傳統光電廠迎華麗轉身，高階散熱質變效益全面兌現
- 晶片大尺寸化驅動 Stiffener 與 Lid 價量齊揚
- AI 晶片 TDP 急升驅動散熱朝封裝層級(MCL)演進

傳統光電廠迎華麗轉身，高階散熱質變效益全面兌現：一詮過去以 LED 導線架與精密金屬沖壓為營運主力，但因持續面對成熟市場競爭與價格壓力，公司自 2024 年 8 月起全面加速轉型，聚焦晶片級與先進封裝散熱解決方案。一詮憑藉長達十年的均熱片(Heat Spreader)研發基礎，成功切入高運算密度(HPC)與先進封裝供應鏈，由傳統電子零組件廠質變為 AI 算力基礎設施之晶片級散熱關鍵供應商。

晶片大尺寸化驅動 Stiffener 與 Lid 價量齊揚：隨著 AI 與 HPC 晶片邁向大尺寸封裝及 Chiplet 架構，矽晶圓與基板間熱膨脹係數不匹配所導致的翹曲(Warpage)問題日益嚴重，使得用於維持結構剛性與散熱效益的補強框(Stiffener)與高階均熱片(Lid)地位大幅升級；由於晶片尺寸放大直接帶動用料面積增加，加上跨世代晶片設計趨於複雜且客製化門檻提高，推升產品平均單價持續向上。隨著晶片功耗持續推升，TIM1 未來極有可能轉向液態金屬等新材料以進一步降低熱阻，屆時均熱片表面處理將衍生出高門檻的鍍金(Gold Plating)加工需求；鍍金等高附加價值工序不僅能大幅拉升產品單價與毛利，更將構築出極高之技術壁壘，一詮憑藉在精密金屬加工與表面鍍金技術的長期累積，將成為此波先進封裝規格升級與潛在材料變革趨勢下的最大受惠者。

AI 晶片 TDP 急升驅動散熱朝封裝層級(MCL)演進：隨著 AI 晶片功耗(TDP)持續急速飆升，散熱技術正由系統層級散熱(System-Level Cooling)，加速邁向整合封裝、冷板與流體設計的封裝層級散熱(Package-Level Cooling)，如 MCL 演進。由於 MCL 涉及複雜流道、微米級精度及嚴苛的防腐與密封要求，其中高階電鍍品質更是決定產品耐蝕性與壽命的重中之重；一詮憑藉在精密金屬加工與電鍍製程累積的技術護城河，已全面投入 MCL 產品開發與多架構驗證。儘管短期對營收貢獻尚有限，但公司提前布局，將在次世代微流道封裝散熱浪潮中搶占先發優勢。

風險因素：AI 需求下滑、公司擴產時程不如預期。

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	5,196	5,069	5,492	6,046	8,709	13,033
營業毛利淨額	578	717	771	860	2,131	3,980
營業利益	-1	177	-23	119	887	2,871
稅後純益	103	201	19	51	726	2,234
公告基本 EPS(元)	0.47	0.92	0.08	0.22	--	--
調整後 EPS(元)	0.47	0.92	0.08	0.22	3.04	9.36
營業收入 YoY(%)	-13.23%	-2.45%	8.36%	10.09%	44.04%	49.65%
稅後純益 YoY(%)	-72.51%	94.49%	-90.64%	169.14%	1,334.18%	207.68%
本益比	45.07	50.12	1,401.05	426.03	71.84	23.35
本淨比	1.16	2.44	5.04	4.23	8.78	6.50
股息(元)	0.40	0.65	0.50	0.50	0.50	0.50
殖利率(%)	0.92%	0.67%	0.63%	0.18%	0.23%	0.23%
ROE(%)	2.55%	4.83%	0.63%	1.35%	13.05%	31.98%

● 產業概況與產品概況

AI 高算力時代帶動封裝升級，Lid 與 Stiffener 成為關鍵可靠度零組件：隨著 AI GPU 算力持續提升及晶片尺寸(Die Size)逐漸逼近光罩極限(Reticle Limit)，先進封裝透過 2.5D/3D 架構整合 GPU、HBM 與高速互連元件，使單一封裝體積與功耗大幅增加。然而，大尺寸封裝亦帶來熱設計功耗(TDP)提升、熱膨脹係數差異(CTE Mismatch)及機械應力增加等問題，使傳統封裝結構面臨可靠度與散熱效率挑戰。因此，下一世代 HPC 封裝設計除需強化晶片與基板(Substrate)間的電性連接外，更需透過 Stiffener(補強環)與 Lid(金屬蓋板)進行結構與熱管理優化，其中 Stiffener 可提升封裝剛性、抑制熱誘發翹曲(Thermal Warpage)，而 Lid 則扮演晶片與散熱系統間的重要熱傳介面，以兼顧高功耗運算下的可靠度與散熱需求。

隨著 AI GPU 朝向更大尺寸封裝、更高功耗及 Chiplet/HBM 異質整合方向發展，傳統單片式 Lid 架構逐漸面臨設計限制，單一結構需同時滿足機械支撐、封裝平整度及熱傳效率等多重需求，難度持續提高。因此，我們認為未來封裝設計不排除朝向雙層式(Two-piece Lid)或功能分離式 Lid 架構演進。我們認為 AI 封裝尺寸放大與功耗提升將持續推升 Lid 與 Stiffener 的重要性，帶動相關供應鏈價值量提升。

一詮散熱元件包含 Stiffener 與 Lid：目前公司 AI 散熱元件主要產品為 Stiffener 與 Lid。根據我們對供應鏈的調查，隨著 AI 晶片封裝尺寸持續放大，市場正逐步由傳統 Lid 方案轉向採用 Stiffener，以提升封裝結構剛性、抑制晶片翹曲(Warpage)，並改善整體散熱效能。目前 Stiffener 已占公司散熱元件營收約 40%，主要出貨客戶包括 Google TPU、AWS T2/T3 以及 Broadcom AI ASIC 等產品。至於 AMD 方面，公司目前已與客戶接洽並參與相關專案，但考量 AMD AI 平台現階段出貨規模仍相對有限，加上公司產能有限，將優先配置產能予高需求、高確定性客戶，因此 AMD 相關貢獻仍不顯著。展望 2027 年，若 AMD AI 平台需求進一步放量，且公司產能同步擴充，預期將有機會切入更多 AMD 相關產品，成為未來新增成長動能。隨 AI GPU 封裝尺寸放大，對封裝平整度與結構支撐要求提升，預期 Stiffener 單價將同步提高。

Lid 產品應用範圍相對廣泛，包含 AI Server、車用電子與傳統高階 IC 等市場。目前 Lid 業務仍以 Grace CPU 平台量產出貨為主，後續 Blackwell 與 Vera Rubin 等新平台則有望逐步導入 Lid 產品。另一方面，公司持續供應 Microsoft 高階 Lid 產品，雖量體相對其他 CSP 較小，但因採用銅片 TIM 1 方案及鍍金製程，產品 ASP 較 Grace CPU 高至少 50%，對營收與獲利仍具貢獻。

散熱技術由 Rack-Level Cooling 走向 Package-Level Cooling：隨著生成式 AI、大型語言模型(LLM)與高效能運算(HPC)需求快速成長，AI GPU 的算力與功耗持續呈現非線性提升。以 NVIDIA 平台為例，自 Hopper、Blackwell 一路演進至 Rubin 世代，單顆 GPU 功耗已由 700W 提升至 1,200W 以上，Rubin Ultra 更有望上探 2,000W 以上，單機架功耗亦由過去 10~20kW 快速攀升至 120kW 以上，未來甚至將朝 300~600kW 等級邁進。然而，隨著 GPU 功耗持續提升，散熱瓶頸已不再僅存在於冷卻能力不足，而是逐漸轉向如何降低晶片熱源至冷卻介質之間的熱傳阻抗(Thermal Resistance)，並提升整體液冷系統的流體管理效率。

圖表一、Nvidia 平台整理

	2022	2023	2024		2025	2026	2027
架構平台	Hopper		Blackwell			Rubin	
CPU平台			Grace			Vera	
系列晶片	H100	H200	GB200/B200	GB300(Ultra)	B300	VR200	VR300(Ultra)
單顆GPU TDP	700	700	1,200/700	1,400	600	1,800/2,300	3,600
Rack TDP	10~25kW	15~30kW	120/14kW	130kW	60~120kW	300+kW	600+kW
散熱方式	Air	Air	Air+Liquid	Air+Liquid	Air+Liquid	Liquid	Liquid

資料來源: 中信投顧整理

因此，AI 散熱技術正由過去以水冷板(Cold Plate)、CDU 及冷卻循環系統(Cooling Loop)為核心的系統層級散熱(System-Level Cooling)，逐步朝向整合封裝、冷板與流體設計的封裝層級散熱(Package-Level Cooling)演進。未來散熱競爭將不再只是透過增加冷卻液流量或擴大水冷板尺寸來提升效率，而是透過縮短熱傳路徑、降低界面熱阻，使散熱能力更接近晶片熱源，以滿足下一世代 2kW 以上 GPU 所帶來的高熱通量需求。

傳統 GPU 封裝的熱傳路徑為：

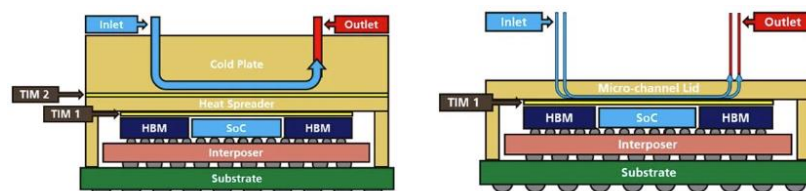
Die → TIM1 → IHS(Heat Spreader) → TIM2 → Cold Plate → Coolant

其中，TIM2 及 IHS 皆會增加額外的界面熱阻(Thermal Interface Resistance)。當 GPU 功耗突破 1kW 後，即使持續提升冷板性能，熱量仍容易累積於晶片與冷板之間，使 TIM2 逐漸成為散熱瓶頸。因此，新一代液冷架構開始重新設計封裝與冷板結構，透過微流道(Microchannel)設計及流道整合，使冷卻液更加接近熱源，部分方案甚至可省略 TIM2，使熱傳路徑縮短為：

Die → TIM1 → Microchannel Cold Plate → Coolant

藉由減少熱傳介面，不僅可有效降低熱阻，更能提升高熱通量環境下的散熱效率，未來 MCL 重要性將持續提高。我們認為，這代表 AI 散熱技術已由傳統機架層級的液冷設計，逐步朝向封裝與散熱共同設計(Package Co-design)的方向發展。

圖表二、Cold Plate/MCL 解決方案



資料來源: UBS、中信投顧整理

除了封裝散熱技術升級外，AI 機架功率密度快速提高，也同步帶動液冷流體管理架構的重要性。傳統液冷系統仰賴大量軟管進行供、回水配置，不僅增加壓降與漏液風險，也使高密度機架的空間利用率受到限制。因此，MCL (Manifold Coolant Line) 開始成為新一代液冷系統的重要架構，其透過整合式金屬歧管(Integrated Manifold)集中管理供、回水流道，可有效降低配管複雜度、提升機架空間利用率、降低漏液風險，同時搭配 Blind Mate UQD (Universal Quick Disconnect) 快拆接頭，使 Server 可在不停機狀況下進行熱插拔維護，進一步提升 AI 資料中心的維運效率與可靠性。

圖表三、NV 機櫃密度逐漸提升



一詮具備高精密加工與電鍍能力，有望成為 MCL 供應商之一：一詮長期投入精密金屬加工及電鍍製程，過去產品主要應用於高精密結構件領域，累積多年的製程控制與量產經驗。由於 MCL 產品涉及複雜流道加工、尺寸精度控制、表面防護及長時間液冷可靠度要求，其中電鍍品質將直接影響產品耐蝕性、密封性及使用壽命，因此具備高階電鍍能力的廠商相對具備競爭優勢。目前一詮已投入 MCL 相關產品開發，並針對不同架構進行設計驗證、製程優化及量產準備。由於 MCL 仍需經過客戶驗證、可靠度測試及平台導入流程，短期內對營收貢獻仍有限，但公司提前布局有助於建立先發優勢。

根據近期供應鏈訪查，市場原先預期 MCL 將於 Rubin Ultra 平台導入，但目前導入時程可能延後至 NVIDIA Feynman 平台。我們認為，此變化主要來自 NVIDIA 仍持續優化下一代 AI Rack 液冷架構，而非 MCL 技術方向改變。隨著未來 GPU 功耗持續提升，液冷架構勢必朝向更高整合度及更靠近封裝端發展，MCL 仍將是解決高功耗 AI Rack 流體管理的重要方案。若後續 Feynman 平台正式導入 MCL，一詮憑藉既有精密加工與電鍍製程能力，有望成為受惠供應商之一。由於 MCL 相較傳統散熱零組件具備更高技術門檻及附加價值，若成功量產，不僅可帶動 AI 相關營收占比提升，亦有望改善產品組合與獲利結構，成為公司下一階段成長動能。

一詮 1Q26 營收 16.2 億元，季增 4.8%，年增 20.2%，毛利率 21.05%，季增 5.19ppts，年增 6.54ppts，單季 EPS 達 0.28 元。1Q26 營收與毛利率同步優於市場預期，主因散熱元件營收占比由去年約 29%大幅提升至 43~44%，帶動產品組合持續優化，推升整體獲利能力。我們認為散熱產品出貨動能已順利延續至 2Q26，預估 2Q26 營收將季增 27.2%至 20.62 億元，毛利率亦可望進一步提升至 22.47%。展望下半年，我們認為隨著多項 AI 散熱專案陸續放量，加上公司擴產設備逐步到位，散熱產品出貨比重可望持續提升，帶動產品組合進一步優化。

● 產能概況

因應 AI 伺服器、高階先進封裝散熱需求快速提升，一詮近年積極調整產品結構，逐步降低傳統低毛利 LED 導線架業務比重，並將部分產線移往中國大陸，釋出台灣廠區空間投入高階均熱片、補強片(Stiffener)及其他 AI 散熱相關產品。由於客戶需求持續強勁，公司目前仍持續接獲增加產能要求，預計今年散熱相關產能將較去年成長超過一倍，2027 年仍有望再擴增一倍。目前新增設備已陸續進廠，由於散熱設備 Lead Time 約 6~9 個月，且設備到位後仍需經過 Setting、測試、客戶驗證及量產流程，因此產能擴充並非一次性完成，預期將隨設備逐步開出。

目前公司稼動率約 65~70%，隨 AI 訂單持續增加，未來仍將持續新增鍛壓設備、擴充五股租賃廠及中國產能，目標 2026 年散熱產值挑戰 36 億元以上，並規劃 2027 年營收達 60 億元以上。

(1)台灣廠為主要散熱生產基地，聚焦高階 AI 產品量產

目前台灣廠營收占比約 70%，仍為公司散熱產品主要生產基地，各廠區分工如下：

- 總部附近廠區：主要負責散熱相關製程
- 總部斜後方廠區：負責散熱片加工、電鍍及鍍金等後段製程
- 五股凌雲路廠區：配置沖壓及測試設備，未來將導入更多高階散熱製程；公司規劃配置 1,200 噸大型沖壓設備，專責高噸位沖壓產品，同時負責小批量試產與 CNC 加工
- 三重光復路新廠：公司去年購入土地，預計 2026 年下半年動工，2027 年底完工，定位為液冷散熱、微流道冷板(MCL)及高階 AI 散熱產品主要研發與量產基地，未來將成為公司長期擴產核心

(2)中國廠加速擴產，鎖定中國 AI 與半導體自主化需求

中國廠目前營收占比約 20%，公司目標 2027 年提升至 30%。受惠中國政府積極推動 AI 產業發展及半導體自主化，當地 AI 伺服器及相關散熱需求快速提升。公司目前於中國布局兩座工廠，其中一座將轉型為散熱專用基地，預計 2026 年下半年開始量產，主要服務中國當地客戶。此外，江門廠具備 3,000 噸廢水處理能力，作為散熱片主要生產基地；同時透過立誠光電新廠新增約 10 條電鍍線，擴充鍍鎳產能，以支應 AI 散熱產品需求成長。

● 公司簡介

一詮成立於 1977 年，主要從事精密沖壓、金屬加工及電子零組件製造，早期產品以 LED 導線架、背光模組等光電零件為主，後續逐步拓展至 IC 導線架、陶瓷基板及散熱相關產品。近年因應 AI 伺服器與高效能運算需求提升，公司積極調整產品結構，將發展重心轉向高附加價值散熱應用，包含均熱片(Heat Spreader)、散熱零組件等。

圖表四、一詮前十大股東(截至 115 年 5 月 27 日)

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
周萬順	23,032,644	9.81%
李忠義	14,156,787	6.03%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	4,426,086	1.89%
花旗(台灣)託管柏克萊資本證券有限公司	2,775,198	1.18%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,522,016	1.07%
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶	2,370,082	1.01%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,346,000	1.01%
花旗(台灣)商業銀行受託保管 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶	2,302,000	0.98%
黃淑貞	1,960,391	0.84%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	1,716,608	0.73%

資料來源：一詮、中信投顧整理

圖表五、一詮產品組合

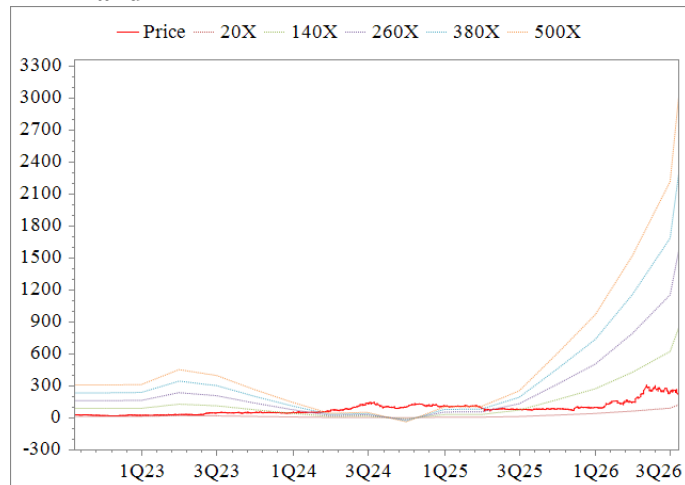
營收占比	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
散熱元件	21%	27%	29%	32%	44%	46%
導線架	41%	39%	39%	38%	30%	25%
陶瓷電路板	15%	12%	12%	11%	10%	14%
TV背光模組	11%	10%	9%	9%	8%	7%
智能服務機器人	7%	7%	7%	7%	5%	5%
Others	5%	4%	4%	3%	4%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

資料來源：一詮、中信投顧整理

2026/07/23

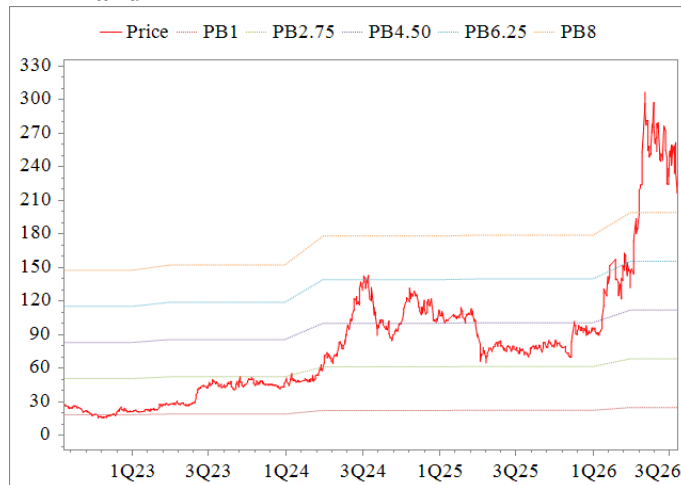
(百萬元)	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
營業收入	1,620	2,062	2,403	2,623	2,723	3,213	3,492	3,605
營業成本	1,279	1,599	1,797	1,904	1,934	2,238	2,419	2,463
營業毛利	341	463	607	720	790	976	1,073	1,141
營業費用	228	295	346	375	281	289	276	263
營業利益	113	168	261	344	509	686	797	878
營業外收支淨額	-27	51	45	34	24	38	34	28
稅前純益	86	219	306	378	533	724	831	906
所得稅	24	59	76	98	133	181	208	227
稅後純益	62	155	227	277	398	538	620	678
調整後 EPS(元)	0.28	0.65	0.95	1.16	1.67	2.26	2.60	2.84
毛利率(%)	21.05%	22.47%	25.25%	27.43%	29.00%	30.36%	30.74%	31.66%
營業利益率(%)	6.99%	8.17%	10.85%	13.13%	18.70%	21.36%	22.84%	24.36%
稅後純益率(%)	4.10%	7.53%	9.46%	10.56%	14.61%	16.75%	17.74%	18.80%
營業收入								
QoQ(%)	4.81%	27.26%	16.56%	9.15%	3.81%	17.99%	8.67%	3.23%
YoY(%)	19.91%	29.07%	54.90%	69.70%	68.08%	55.83%	45.29%	37.41%
營業利益								
QoQ(%)	443.59%	48.63%	54.79%	32.08%	47.89%	34.77%	16.19%	10.13%
YoY(%)	973.07%	180.82%	859.16%	1,551.78%	349.40%	307.50%	205.88%	155.05%
稅後純益								
QoQ(%)	419.48%	133.41%	46.46%	21.87%	43.68%	35.26%	15.11%	9.38%
YoY(%)	--	--	344.15%	2,064.14%	498.55%	246.86%	172.61%	144.68%

PER Band



資料來源：中信、CMoney

PBR Band



資料來源：CMoney

2026/07/23

資產負債表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	1Q26
資產總計	7,793	7,797	11,015	12,388	14,266
流動資產	4,845	5,237	5,656	5,631	6,104
現金及約當現金	1,312	1,492	1,355	1,170	1,341
應收帳款與票據	1,900	2,133	2,467	2,690	2,564
存貨	1,327	1,152	1,378	1,468	1,800
採權益法之投資	--	0	47	37	42
不動產、廠房設備	1,956	1,717	4,551	5,690	7,046
負債總計	3,573	3,414	5,630	6,906	8,757
流動負債	1,849	2,688	2,005	2,588	3,197
應付帳款及票據	481	643	715	601	791
非流動負債	1,724	726	3,624	4,318	5,560
權益總計	4,221	4,383	5,386	5,482	5,509
普通股股本	2,220	2,220	2,340	2,340	2,340
保留盈餘	249	359	237	255	264
母公司業主權益	4,043	4,191	5,208	5,187	5,229
負債及權益總計	7,793	7,797	11,015	12,388	14,266

損益表

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	5,069	5,492	6,046	8,709	13,033
營業成本	4,352	4,722	5,187	6,578	9,053
營業毛利淨額	717	771	860	2,131	3,980
營業費用	541	794	741	1,244	1,109
營業利益	177	-23	119	887	2,871
EBITDA	723	510	579	1,495	3,479
業外收入及支出	68	89	-31	103	124
稅前純益	244	66	88	990	2,995
所得稅	46	36	17	258	749
稅後純益	198	30	71	726	2,234
公告基本 EPS(元)	0.92	0.08	0.22	--	--
調整後 EPS(元)	0.92	0.08	0.22	3.04	9.36

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

現金流量表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	1Q26
營業活動現金	919	845	220	351	92
稅前純益	130	244	66	88	86
折舊及攤銷	481	454	420	413	115
營運資金變動	505	105	-487	-428	-14
其他營運現金	-197	42	221	279	-95
投資活動現金	-460	-185	-3,447	-1,670	-1,235
資本支出淨額	-385	-108	-3,425	-1,623	-1,224
長期投資變動	-71	-76	21	-15	2
其他投資現金	-4	-1	-43	-32	-13
籌資活動現金	-314	-449	3,039	1,134	1,261
長借/公司債變動	-6	-265	2,262	665	999
現金增資	0	0	864	0	0
發放現金股利	-111	-87	-144	-117	0
其他籌資現金	-197	-97	57	586	262
淨現金流量	164	180	-138	-184	171
期初現金	1,149	1,312	1,492	1,355	1,170
期末現金	1,312	1,492	1,355	1,170	1,341

資料來源：中信、CMoney

比率分析

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
成長力分析(%)					
營業收入淨額	-2.45%	8.36%	10.09%	44.04%	49.65%
營業毛利淨額	24.01%	7.50%	11.51%	147.89%	86.80%
營業利益	--	--	--	647.94%	223.78%
稅後純益	116.31%	-85.07%	136.57%	1334.18%	207.68%
獲利能力分析(%)					
毛利率	14.15%	14.04%	14.22%	24.47%	30.54%
EBITDA(%)	14.26%	9.29%	9.57%	17.17%	26.70%
營益率	3.48%	-0.41%	1.96%	10.18%	22.03%
稅後純益率	3.92%	0.54%	1.16%	8.34%	17.14%
ROE(%)	4.83%	0.63%	1.35%	13.05%	31.98%

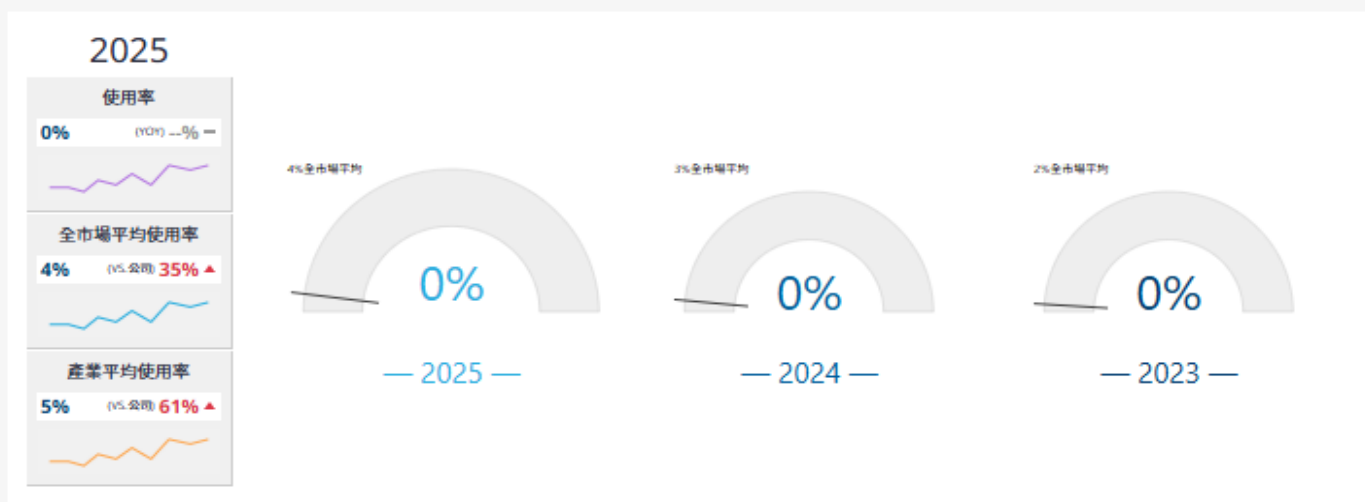
2026/07/23

ESG 資訊-環境保護(Environmental)

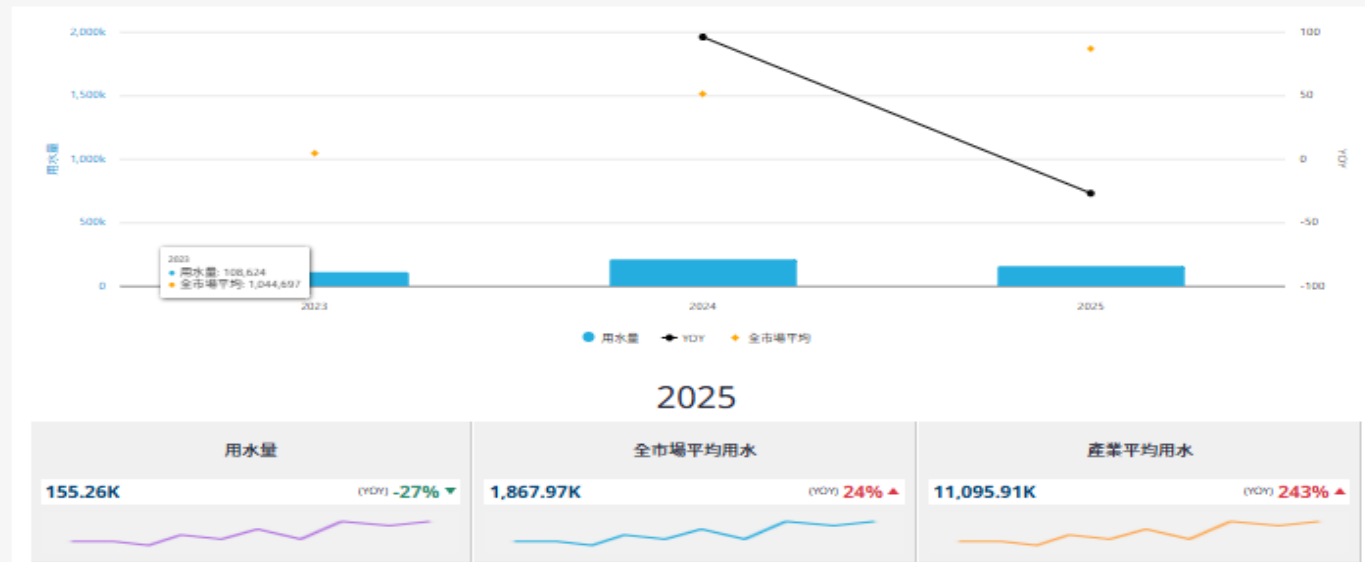
溫室氣體(範疇一/二)排放量



再生能源使用率



用水量



2026/07/23

廢棄物量



2025



密集度

2025

溫室氣體排放密集度

15.37

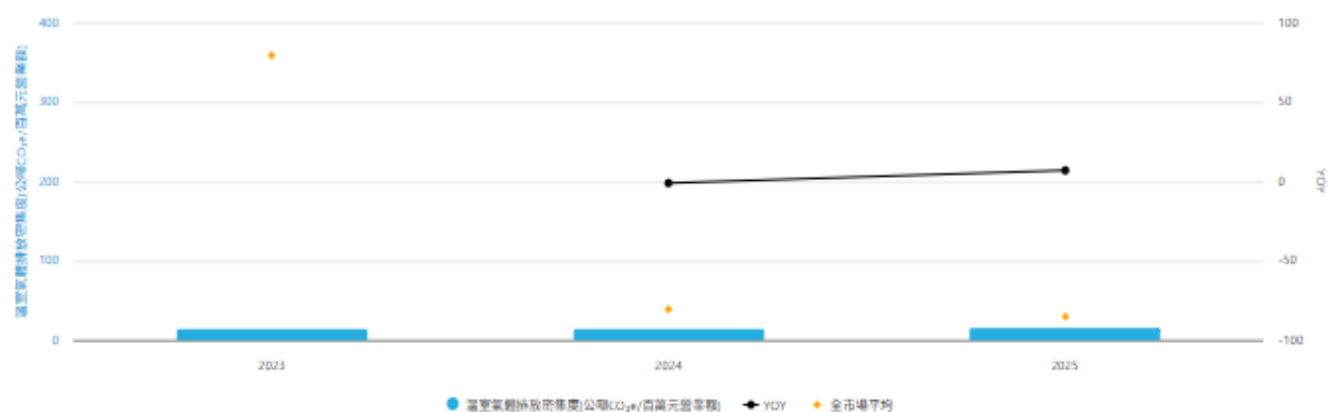
用水密集度

49.371

廢棄物密集度

0.188

溫室氣體排放密集度(公噸CO₂e/百萬元營業額)

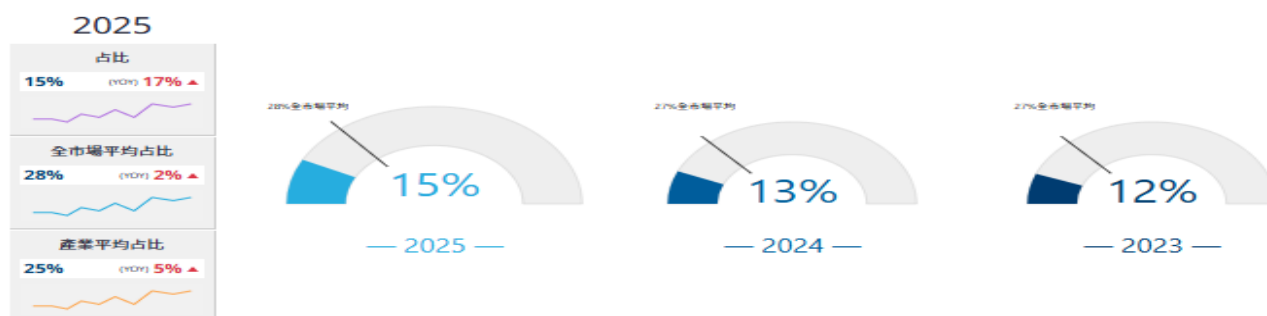


2025

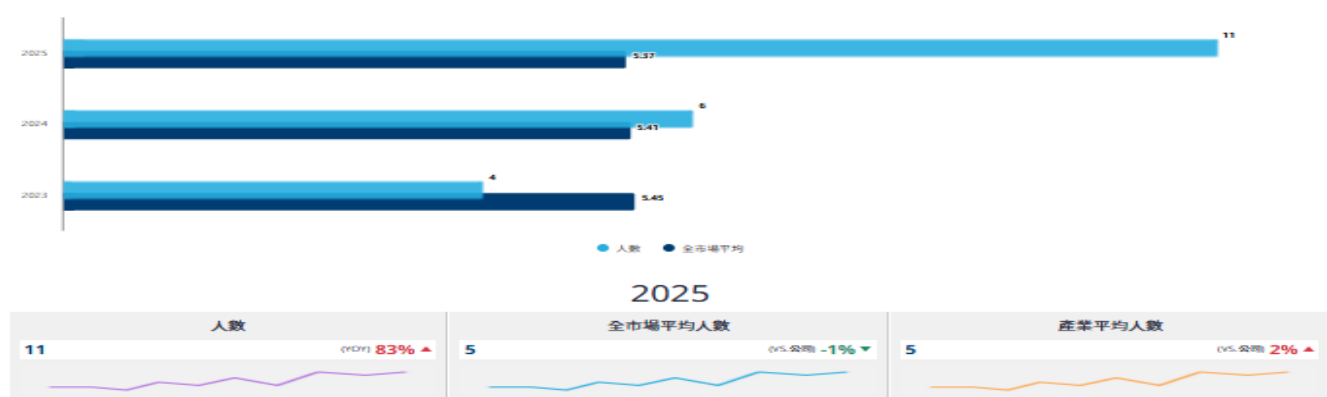


ESG 資訊-社會責任(Social)

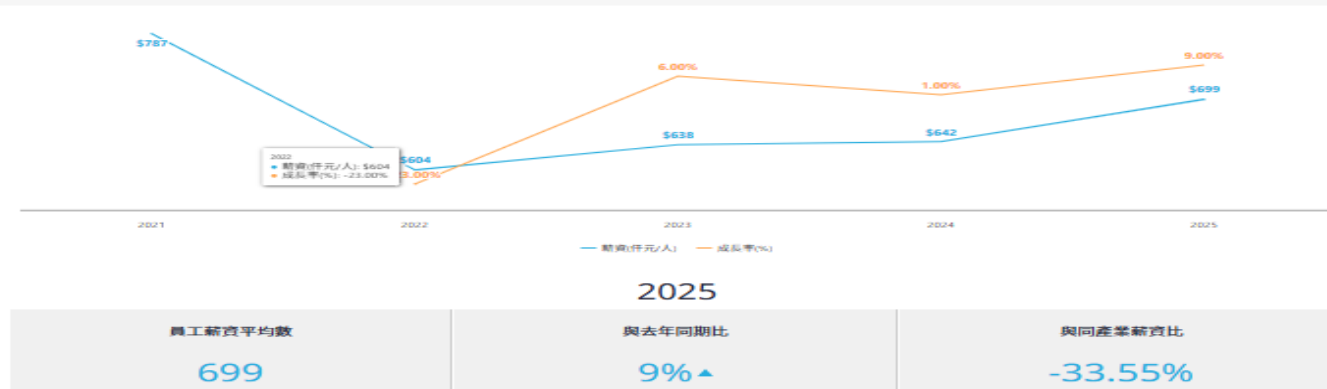
管理職女性主管占比



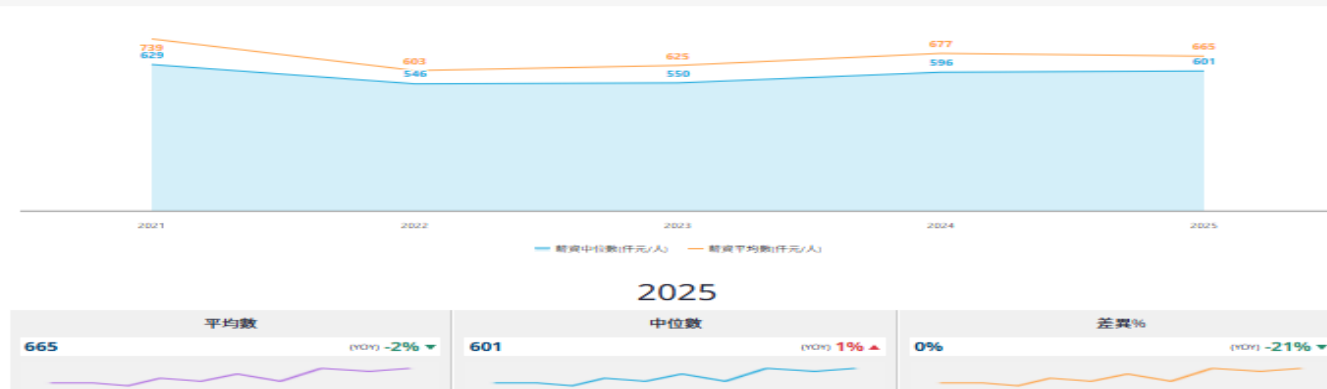
職業災害人數



員工薪資年度趨勢

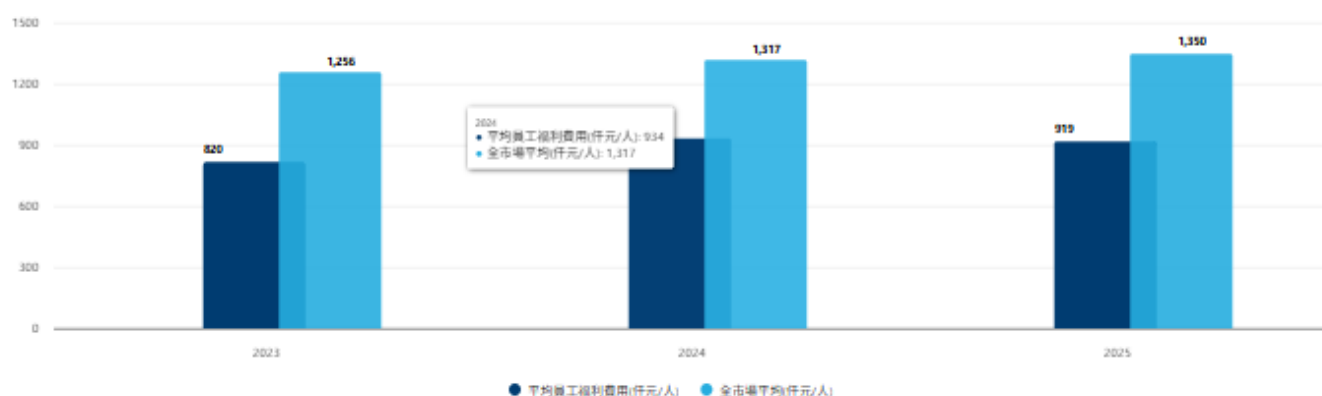


非擔任主管職務之全時員工薪資



2026/07/23

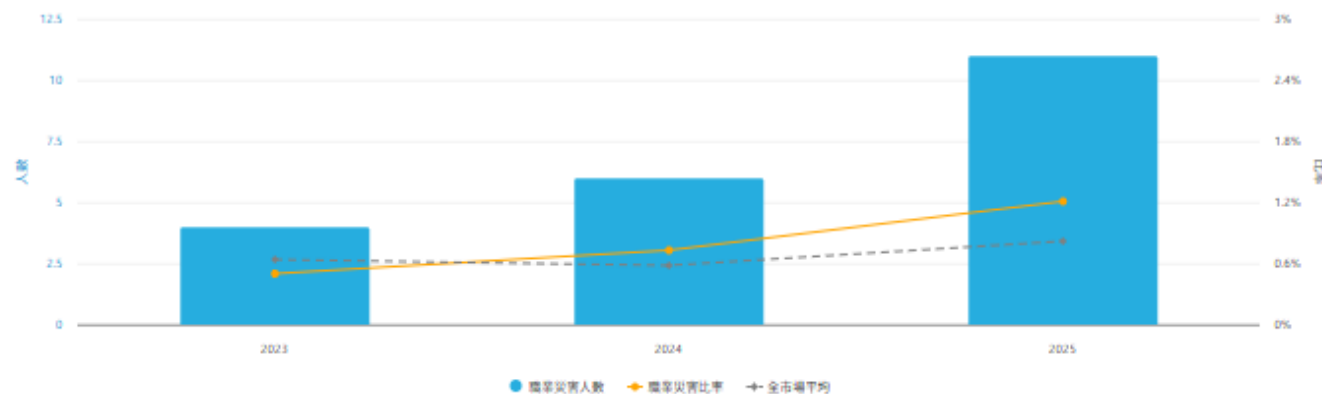
平均員工福利費用



2025



職業災害人數與比率

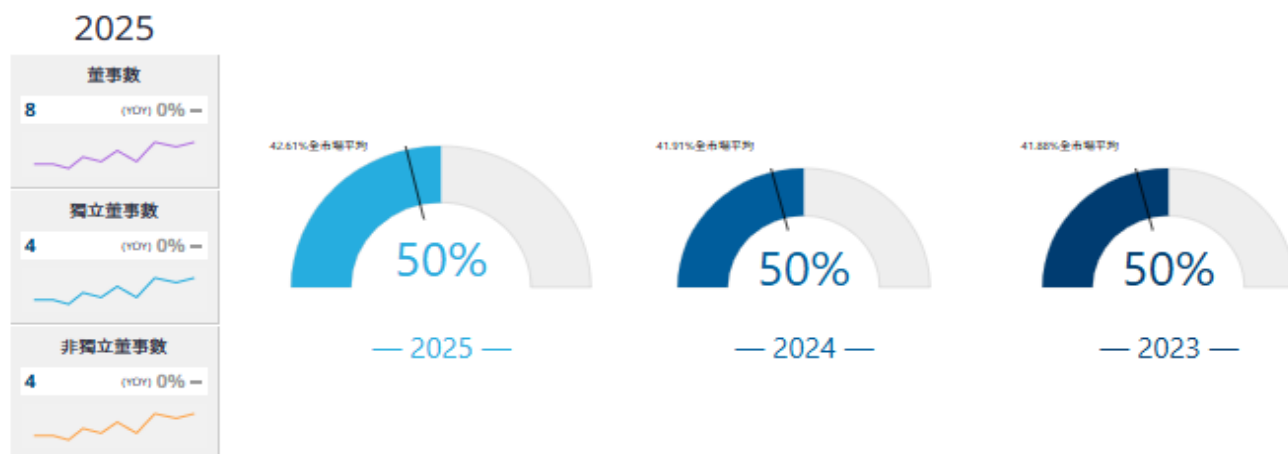


火災件數與死傷人數

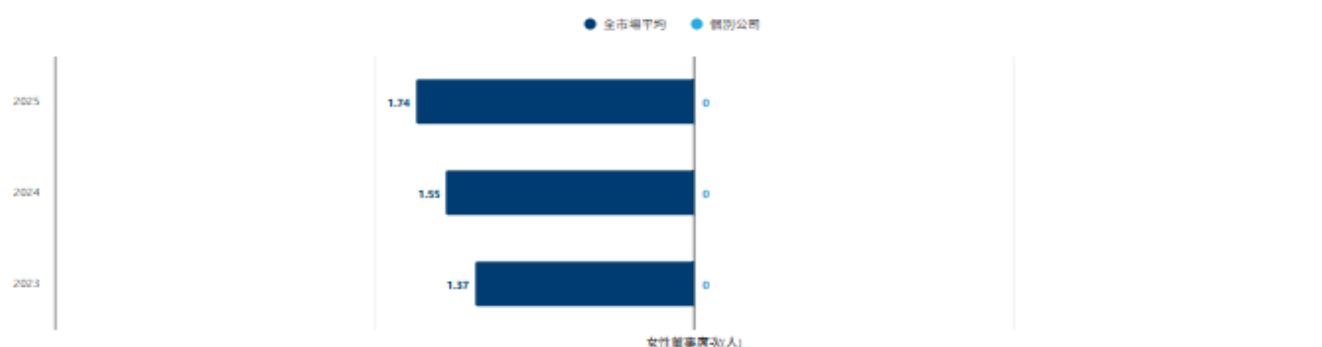


ESG 資訊-公司治理(Governance)

獨立董事vs.董事席次占比



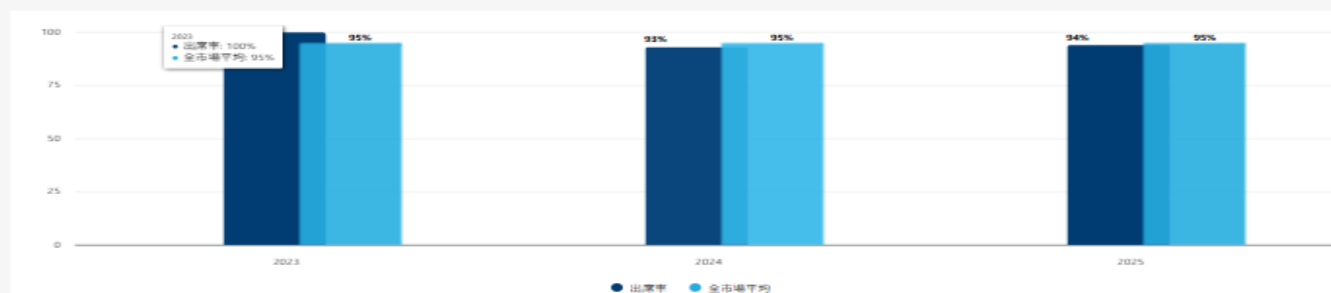
女性董事席次



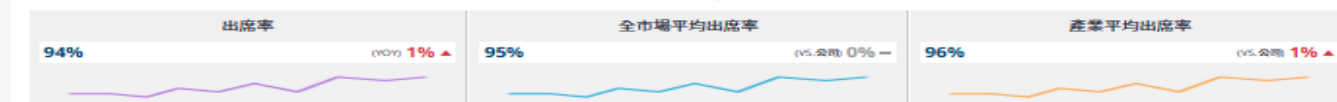
2025



董事之董事會出席率



2025



2026/07/23

董事進修符合進修要點比率

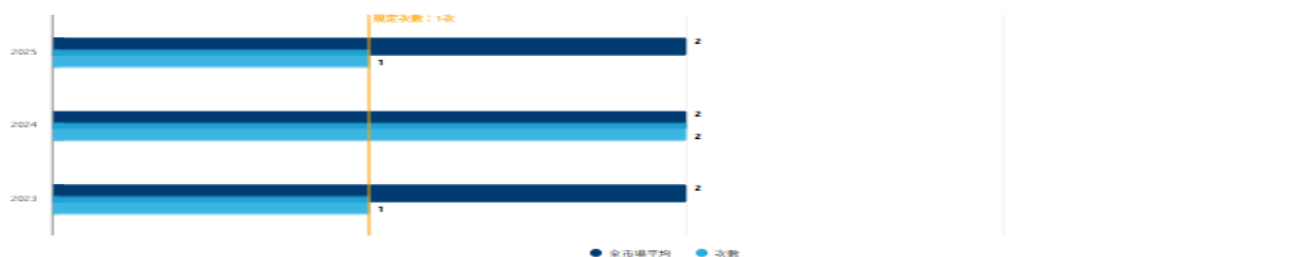


內圈:個別公司 外圈:全市場平均

2025



法說會次數



2025



薪酬委員會出席率

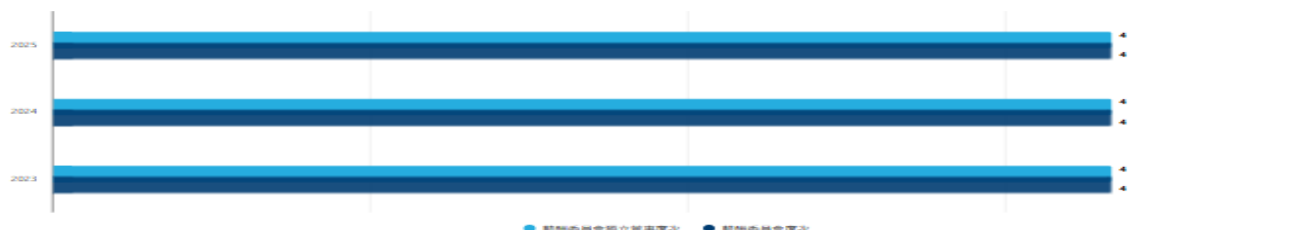


內圈:個別公司出席率 外圈:全市場平均出席率

2025



薪酬委員會席次



資料來源:證交所

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號